

易華電子股份有限公司



股票代號：6552

2023/11/21

本簡報中對產業未來的展望為反映本公司截至目前為止的看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。



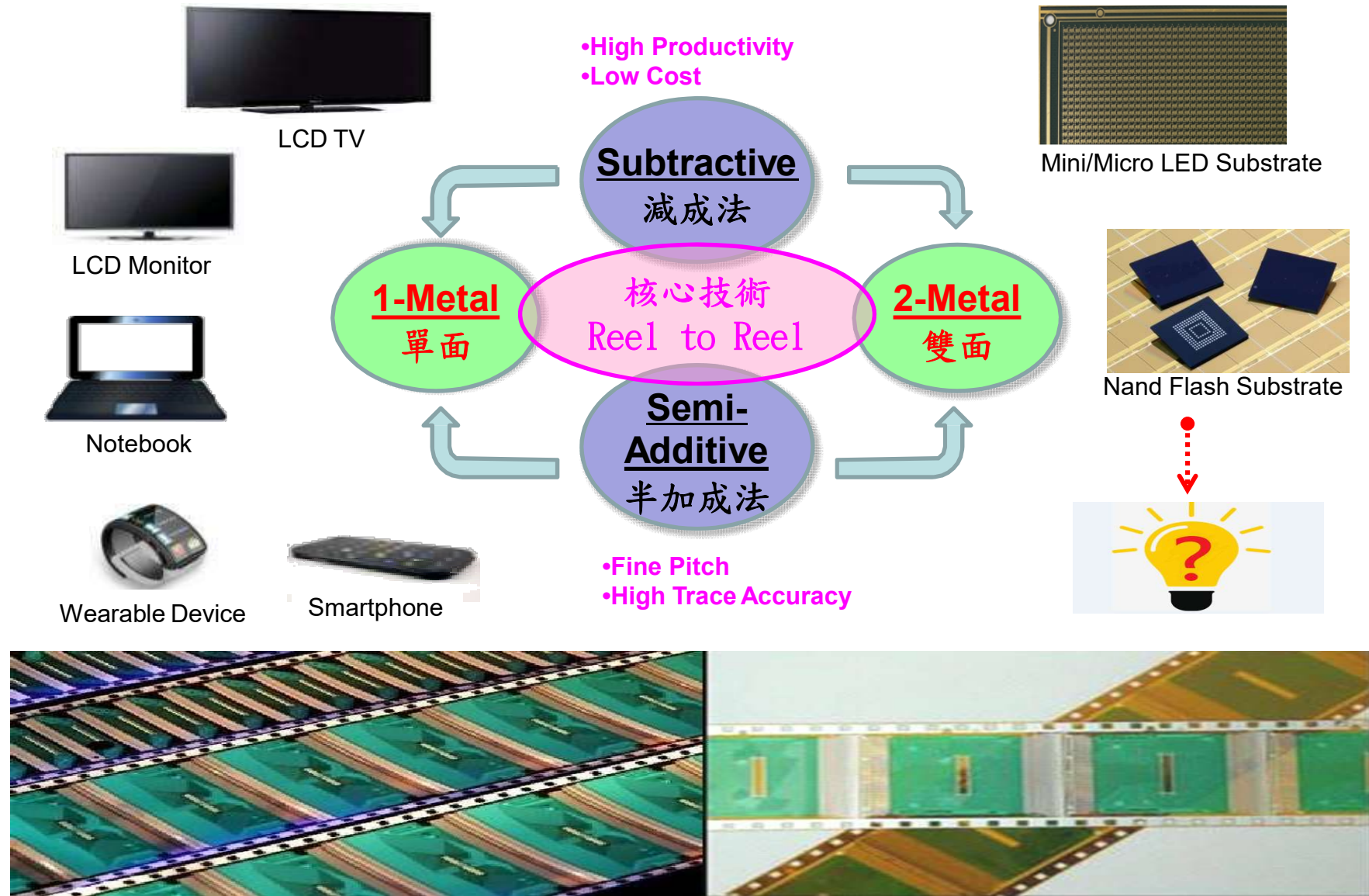
-Professional Reel-to-Reel Fine-Pitch Service

一、公司概況-基本資料

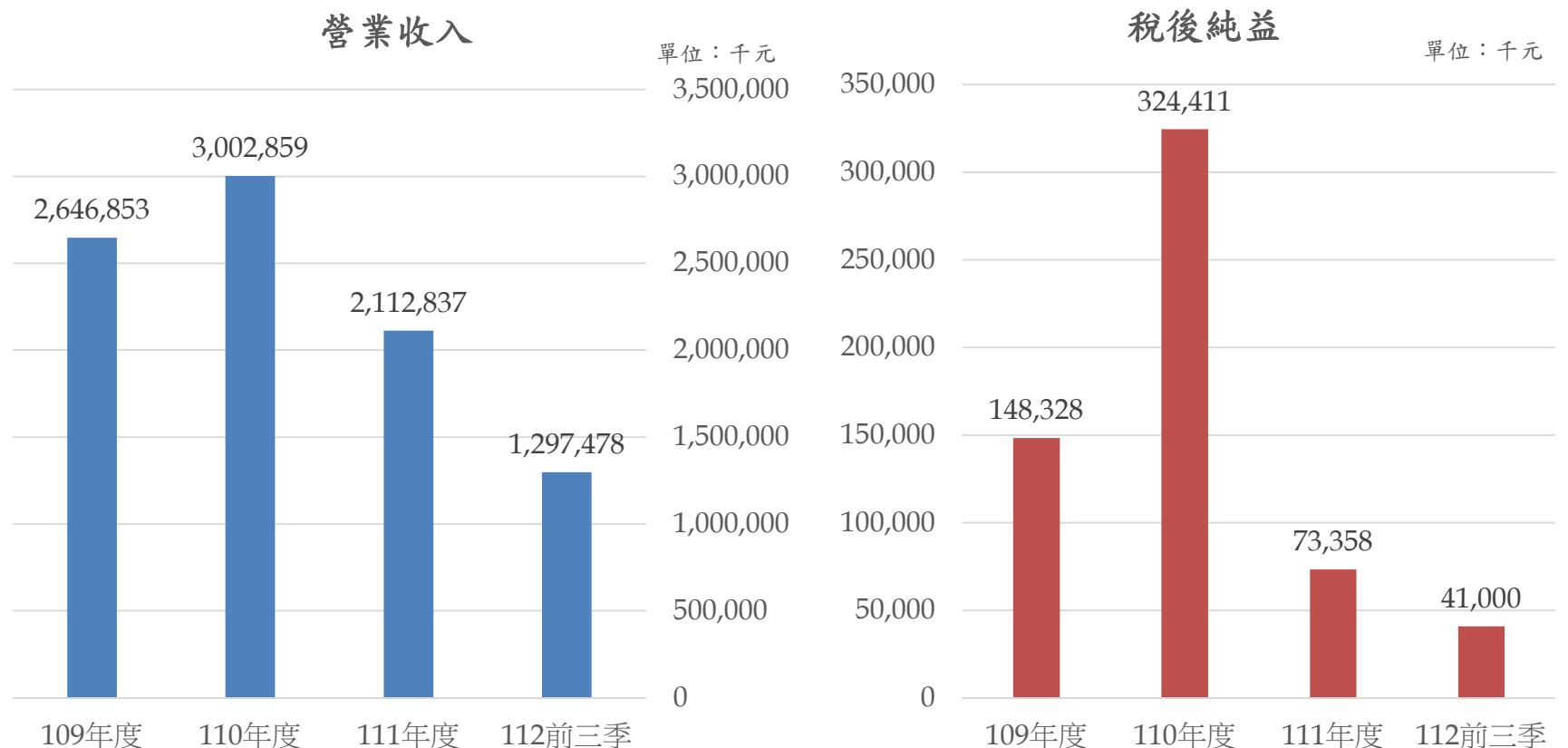
- 公司設立：1973年10月6日(原名台灣住礦電子股份有限公司)
- 董事長：萬文財
- 總經理：李宛霞
- 實收資本：新台幣8.3億元
- 主要股東：長華42.8%、南茂10%
- 員工人數：616人(截至2023年10月底)
- 主要產品：捲帶式高階覆晶薄膜IC基板(Reel to Reel Chip on Film)
- 地址：高雄市楠梓區新開發路8號



一、公司概況-產品應用



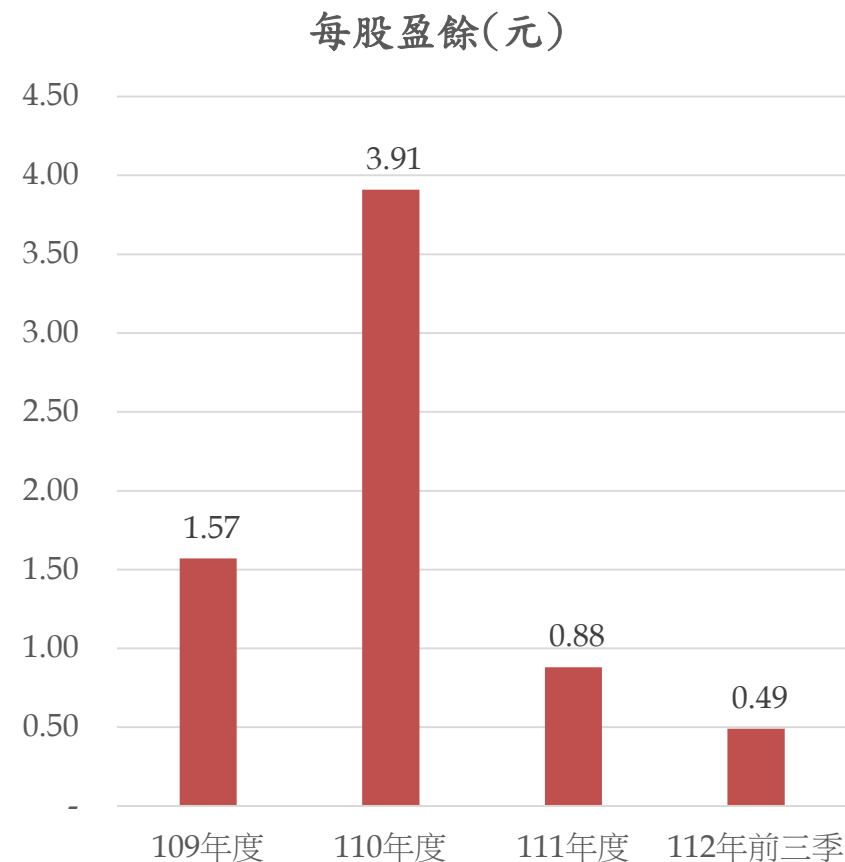
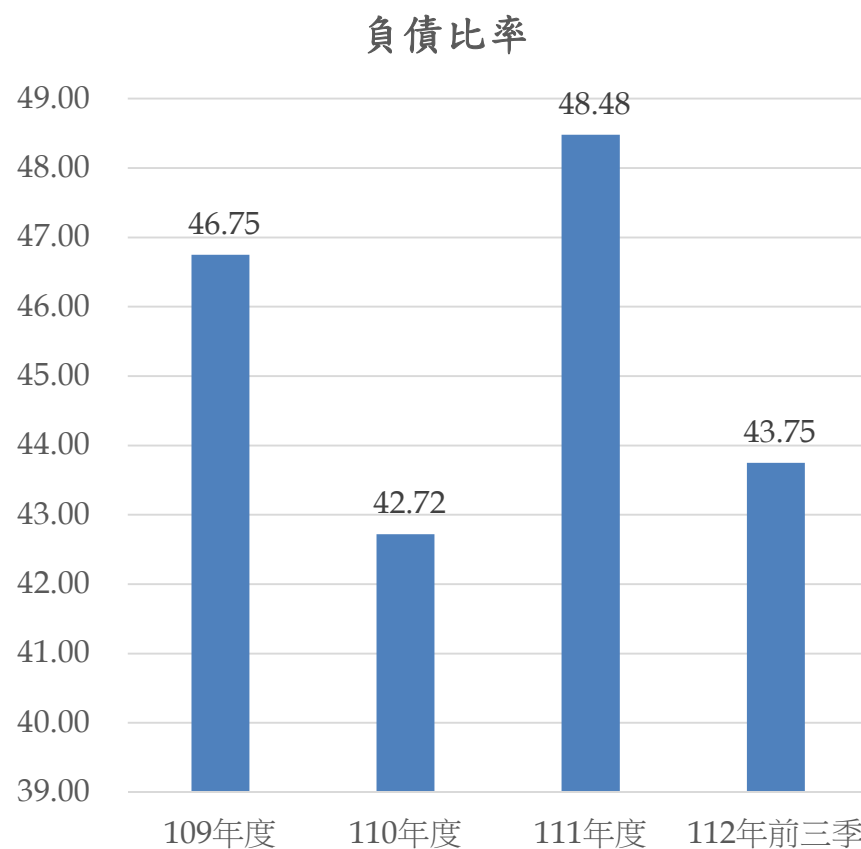
二、營運績效-歷年營收及獲利



單位：新台幣千元

年度	109年度	110年度	111年度	112前三季
營業收入	2,646,853	3,002,859	2,112,837	1,297,478
稅後純益	148,328	324,411	73,358	41,000

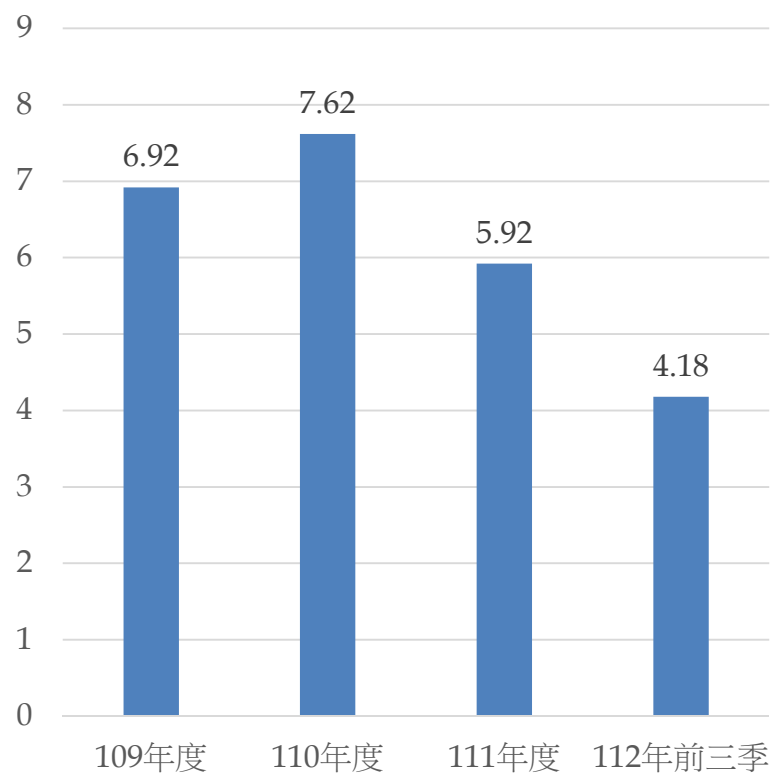
二、營運績效-財務比率分析



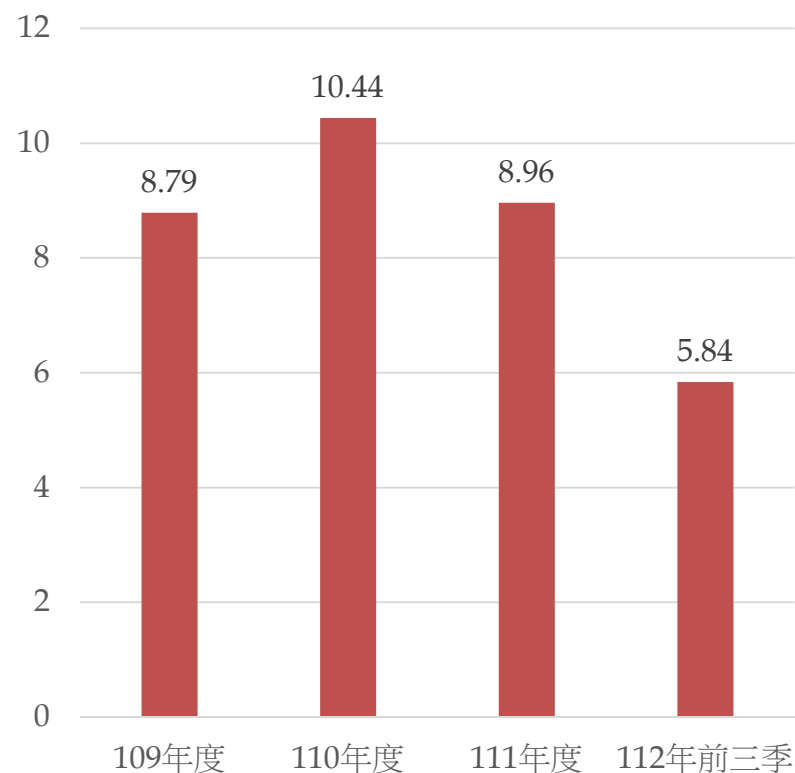
年度	109年度	110年度	111年度	112年前三季
負債比率	46.75	42.72	48.48	43.75
每股盈餘(元)	1.57	3.91	0.88	0.49

二、營運績效-財務比率分析

應收款項週轉率



存貨週轉率



年度	109年度	110年度	111年度	112年前三季
應收款項週轉率	6.92	7.62	5.92	4.18
存貨週轉率	8.79	10.44	8.96	5.84

三、市場狀況與業務展望-1 Metal COF for 大尺寸面板

✓ 目前：戰爭、通貨膨脹、經濟成長停滯，影響全球民生需求

- * 全球經濟成長預測持續下修。
- * 戰爭及地緣性衝突持續不斷增加，造成電子產品終端應用市場雜音不斷。
- * TV面板及IT面板產值在2020及2021年大幅成長，尤其在2021年，高達3~4成之成長率。但自2022年起，高成長之市場需求下滑，2023年面板廠持續減產及去化庫存。
- * 預計2024年面板市場有機會回到傳統需求模式，2025年間回歸為穩定需求市場。

✓ 未來：新設計、新應用…，趨勢不變；需求時間遞延

- * TV面板 – 4K -> 8K趨勢已然呈現，靜待市場需求。
- * Monitor/NB/Tablet面板 – 開始出現無邊框應用；由COG轉為COF的設計。
- * 車用面板 – 開始COF的設計。

三、市場狀況與業務展望 - 1 Metal COF for 小尺寸面板

✓ 目前：手持式裝置用驅動IC設計趨勢更迭

- * 手機面板用驅動IC晶片，COP設計增加，因此COF使用量持續降低。
- * 手錶手環兼具健康管理功能成為顯學，COF在此領域用量需求穩定成長。

✓ 未來：新設計、新應用…，趨勢不變

- * 高階手機用軟性OLED – COP 增加，1-Metal COF減少
- * 中階手機用硬屏OLED/LTPS – FHD TDDI/FTDDI用 1-Metal COF，部分用 COG。
- * 低階手機用面板 – 使用COG。
- * Wearable面板 – 穿戴裝置面板由於邊框要求，陸續由COG轉為1-Metal COF設計，市場需求穩定成長。

三、市場狀況與業務展望 - 2 Metal IC Substrate

✓ 目前：MiniLED直顯和背光市場並進，應用開枝散葉

- * 2021年堪稱Mini LED相關產品增量的一年，加速2022年下世代顯示技術發展。於2022年初CES展會上，各品牌廠積極發表新型顯示器，其中不乏Micro LED相關產品，足見廠商重視先進顯示產品市場發展。
- * 2023年Mini/Micro LED的開發與應用積極活絡。
- * 預期2024年2 Metal IC Substrate，有機會開始應用於Mini/Micro LED產品。

✓ 未來：新設計、新應用...

- * 易華 2-Metal 技術 除了Mini/MiniLED IC Substrate的開發應外，亦將拓展其他IC Substrate的應用領域。

三、市場狀況與業務展望 - 技術與產品開發

✓ 提供客戶全方位軟性IC substrate產品之供應商

製程	競爭優勢	技術/應用	目標產品/新產品
1-Metal Sub 減成法	<ul style="list-style-type: none"> *生產速度快，效率高。 *技術能力自主，生產良率穩定。 	<ul style="list-style-type: none"> *銅厚#~8um *線路>=20um Pitch *腳數=<1440 Channel/48mm 	<ul style="list-style-type: none"> @ LCD TV @ OLED TV @ Dual Cell LCD
1-Metal Semi 半加成法	<ul style="list-style-type: none"> *高精度尺寸控制的COF產品，可以提升面板模組組裝良率；協助客戶降低Total Cost。 *生產良率高及品質穩定性佳，在生產成本上具有絕對的競爭優勢。 	<ul style="list-style-type: none"> *銅厚#~12um *線路>=18/16/14um Pitch *腳數=<1900 Channel/48mm =<3000 Channel/70mm 	<ul style="list-style-type: none"> @ 智慧手機 @ 穿戴裝置 @ FoD @ FTDDI
2-Metal 雙面法	<ul style="list-style-type: none"> *新製程技術開發能力。 *具備設備設計能力。 *成本控制能力佳。 	<ul style="list-style-type: none"> *Thin Film IC Substrate *LED IC Substrate *腳數=<2500 Channel/48mm =<4000 Channel/70mm 	<ul style="list-style-type: none"> @ NAND Flash @ Mini LED @ Micro LED

四、產業概況-驅動IC供應鏈

✓ IC Design House提供total solution



✓ COF廠分佈區域

製程技術		1-Metal(單面)減成法 Subtractive(Etching)	1-Metal(單面)半加成法 Semi-Additive(Plating)	2-Metal(雙面)	
應用	腳數(Channel)/帶寬	=<1400 /48mm	1400~1900 /48mm	1900~2500 /48mm	
		=<2000 /70mm	2000~3000 /70mm	3000~4000 /70mm	
產能	韓國	S社	90~100KK	?KK(2-Metal改1-Metal)	7-10KK
		L社	120~130KK	?KK(2-Metal改1-Metal)	5-7KK
	日本	F社	20KK	X	2KK
		C社	70~90KK	X	X
	台灣	易華	40KK	40KK	5KK
		大陸	ESWIN 上達	? ?	? ?

Q&A

